

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Схема процесса подготовки медной поверхности печатных плат MecEtchBond**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Предварительная очистка**  **MEKLEEN MAC-5330**  Обезжиривание (опция) | | | | | Температура 20 - 30 ° С (стандарт 35 ° C)  Время погружения: 10-30 сек Давление распыления: 0,1 – 0,3 MPa  Время обработки: 15 сек | | |
| промывка водой  (3 ступени) | | | |
| **Микротравление CZ-8100** | | | | | Температура 30 - 40 ° С (стандарт 35 ° C) Давление распыления: 1 - 2 кг / см² Скорость травления: прибл. 0,7 (до 4 мкм)  Время обработки: 25-90 сек. | | |
|  | | | | Промывка водой | | |
| **Кислотная промывка**  10,0% объем, 35% р-р **HC**l  Удаление шлама | | | | | Температура 20 - 30 ° С Давление распыления: 0,3-0,6 кг / см² Время: 10-15 сек. | | |
|  | Промывка водой  (более 2 раз) | | | | | |
| **Обработка от окисления CL-8300**  Образование органической пленки (опция) | | | | | | Погружать или распылять 20 - 30 ° C  Время:10 - 15 сек. | |
|  | | Промывка | | | | |
|  | | Сушка | | | | |

Область применения процесса микротравления MecEtchBond практически не ограничены. Сочетание процессов **MecEtchBond 8100** и процессом **CL-8300** широко используется в качестве альтернативы технологии черного оксидирования меди, что дает высочайшие результаты по силе адгезии.

Адгезия меди со смолой увеличивается благодаря механическому сцеплению за счет микрорельефа поверхности меди и химического сцепления за счет образования химических связей между органическим слоем CL-8300 и смолой.